(19) 日本国特許庁 (JP)

____公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-195852

(43)公開日 平成11年(1999) 7月21日

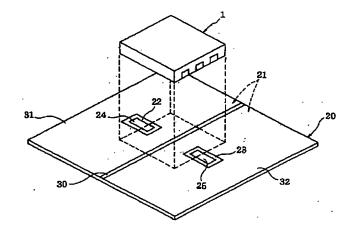
(51) Int. Cl. ⁶ H05K 1/02 H01L 41/09	識別記号	F I H05K 1/02 H03H 9/10	H05K 1/02 N	
H03H 9/10	·	9/25	A	
9/25		H01L 41/08	C	
		審査請求	未請求 請求項の数4 FD (全8頁)	
(21)出願番号	特願平9-368365	(71)出願人	000003104 東洋通信機株式会社	
(22) 出願日	平成 9年(1997)12月29日		神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目1番1号	
		(72)発明者	櫻井 誠 神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号 東洋通信機株式会社内	
		(72)発明者	渡辺 芳久 神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号 東洋通信機株式会社内	
	*	(74)代理人	弁理士 鈴木 均	

(54) 【発明の名称】プリント配線基板ユニット

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 プリント配線基板上に、圧電フィルタ等の圧電デバイスを搭載した場合においても、搭載前のデバイス単独の状態における特性と同等のフィルタ特性が得られるプリント配線基板ユニットを提供する。

【解決手段】 圧電デバイス1を搭載するプリント配線 基板20上には入出力端子に夫々対応する入出力配線パターン24、25と、この入出力配線パターンの夫々の少なくとも一部を包囲するアイソレーション領域22、23と、各アイソレーション領域を隔てて入力及び出力配線パターンの少なくとも一部を包囲するようにプリント配線基板上の所定の範囲に亙って形成されたアースパターン21と、が形成されたものにおいて、アースパターンには、該アースパターンを、入力側アースパターン32と、出力側アースパターン31とに電気的に分断するための絶縁ライン30が形成されている。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 パッケージ底面の対向し合う2つの辺に 沿って夫々配置された入力端子及び出力端子と、該入力 端子側及び出力端子側に夫々配置されたアース端子と、 を備えた圧電デバイスと、この圧電デバイスを搭載する プリント配線基板とから成るプリント配線基板ユニット であって、

前記プリント配線基板上には前記入力端子及び出力端子 に夫々対応する入力配線パターン及び出力配線パターン と、この入力及び出力配線パターンの夫々の少なくとも 10 一部を包囲するアイソレーション領域と、各アイソレー ション領域を隔てて入力及び出力配線パターンの少なく とも一部を包囲するようにプリント配線基板上の所定の 範囲に亙って形成されたアースパターンと、が形成され たものにおいて、

前記アースパターンには、該アースパターンを、入力側 アースパターンと、出力側アースパターンとに電気的に 分断するための絶縁ラインが形成されていることを特徴 とするプリント配線基板ユニット。

【請求項2】 パッケージの底面もしくは側面に形成し 20 た入力端子及び出力端子と、該入力端子及び出力端子と 夫々対となるようにパッケージの底面もしくは側面に形 成した入力側アース端子及び出力側アース端子と、を備 えた圧電デバイスと、この圧電デバイスを搭載するプリ ント配線基板と、から成るプリント配線基板ユニットで あって、

前記プリント配線基板には、入力端子に対応する入力配 線パターンと、出力端子に対応する出力配線パターン と、入力側アース端子に対応する入力側アースパターン と、出力側アース端子に対応する出力側アースパターン 30 と、が形成されており、前記2つのアースパターンが互 いに分離されていることを特徴とするプリント配線基板 ユニット。

【請求項3】 入力端子及び出力端子と、該入力端子及 び出力端子とぞれぞれ対となる入力側アース端子及び出 力側アース端子とを有する圧電デバイスと、この圧電デ バイスを搭載するプリント配線基板とから成るプリント 配線基板ユニットであって、

前記入力端子から供給されアース端子に流れる信号電流 によって生ずるアース電位が前記出力端子から出力され 40 る出力信号に与える影響を軽減するように、前記プリン ト配線基板上のアースパターンを、入力側アースパター ンと出力側アースパターンとに分離したことを特徴とす るプリント配線基板ユニット。

【請求項4】 請求項1、2、3又は4に記載のプリン ト配線基板ユニットを備えたことを特徴とする電子装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

電デバイスを搭載するプリント配線基板の配線構造、特 にSAWフィルタなどの高周波フィルタをプリント配線 基板に実装するのに好適な配線構造を備えたプリント配 線基板ユニットに関するものである。

[0002]

【従来の技術】通信機器の分野においては、高周波化の 要請が年々高まっており、SAWフィルタや多重モード フィルタなどの圧電フィルタに対しても高周波化が要求 されるようになっている。従来、周波数帯域が数10M Hz程度のフィルタをプリント配線基板上に搭載した場 合には発生しなかった特性上の問題が、近年の800M Hz、1.5GHzといった髙周波帯域に対応したSA Wフィルタなどの圧電デバイスを無線機等のプリント配 線基板に搭載した場合には発生しており、特に所望のフ ィルタ特性が得られないという不具合が指摘されてい る。本発明者は、この点を確認するべく以下の実験を行 って上記不具合を再現した。即ち、図10(a)(b)及び (c) は従来の圧電デバイスの一例としてのSAWデバイ スの構造を示す正面縦断面図、平面横断面図、及び底面 図であり、図11(a) 及び(b) はこのSAWデバイスを プリント配線基板上に実装する手順、及び実装後の状態 を示す斜視図であり、図12は実装されたSAWデバイ スのフィルタ特性を示す図であり、図13は実装されな い単体のSAWデバイスのフィルタ特性を示す図であ る。図10に示したSAWデバイス1は、上面が開口し た凹状のセラミックパッケージ2の内底面にSAWデバ イスチップ3を固定すると共に、段部4、5上に形成し た導電パッド6 (6a, 6b, 6c)、7 (7a, 7 b, 7 c) と、チップ3上に形成した電極8 (8 a, 8 b, 8c)、9 (9a, 9b, 9c) とを夫々一対一で ワイヤ10によりボンディング接続している。各導電パ ッド6 (6a, 6b, 6c)、7 (7a, 7b, 7c) は、パッケージ2の内外に配線された複数の導電パター ン11を介して、パッケージ底面(或は側面)に形成さ れた出力側端子群12(出力端子12a, アース端子1 2b, 12c)、入力側端子群13(入力端子13a, アース端子13b, 13c)と一対一で電気的に接続さ れている。パッケージ2の上面は蓋15により閉止され

【0003】このような構成を備えたSAWデバイス1 をプリント配線基板(以下、プリント板という)20上 に搭載する場合には、図11(a) に示すようにプリント 板20の表面には予め全面に亙って金属膜から成る共通 アースパターン21を形成すると共に、SAWデバイス 1の底面の出力端子12a及び入力端子13aと対応す る部分にだけ、夫々矩形環状のアイソレーション領域 (基板面を露出させた絶縁領域) 22、23を形成する ことにより、各アイソレーション領域22、23内部に 出力配線パターン24、入力配線パターン25を隔離形 【発明の属する技術分野】本発明は圧電フィルタ等の圧 50 成している。入出力配線パターン24、25の外側に位

等開平11-195852 4

置するパターン全体を共通アースパターン21として用 いる。このように実装されたSAWデバイス1のフィル 夕特性を測定するに当たっては、図11 (b) のように 入力配線パターン24と、出力配線パターン25に対し て夫々入力側及び出力側同軸ケーブル30、31を介し て測定器機と接続することにより測定を行った。図12 は図2のように実装されたSAWデバイスの特性を示す グラフであり、図13は実装前のSAWデバイス単体の 特性を示すグラフである。なお、各グラフは同軸ケーブ ル30、31の影響を考慮したキャリブレーション処理 10 を施したものを示している。即ち、SAWデバイス1の 入出力アース端子12b、12c、13b、13cを夫 々プリント基板上の共通アースパターン21により接続 したところ、プリント板20に実装する以前の特性(図 13) に比べて、減衰特性が特に通過帯域より低周波側 において20dB以上も劣化することが判明した。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、プリント配線基板上に、圧電フィルタ等の圧電デバイスを搭載した場合においても、搭 20 載前のデバイス単独の状態における特性と同等のフィルタ特性が得られるプリント配線基板ユニットを提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決する為の手段】上記目的を達成する為、請 求項1の発明は、パッケージ底面の対向し合う2つの辺 に沿って夫々配置された入力端子及び出力端子と、該入 力端子側及び出力端子側に夫々配置されたアース端子 と、を備えた圧電デバイスと、この圧電デバイスを搭載 するプリント配線基板とから成るプリント配線基板ユニ 30 ットであって、前記プリント配線基板上には前記入力端 子及び出力端子に夫々対応する入力配線パターン及び出 力配線パターンと、この入力及び出力配線パターンの夫 々の少なくとも一部を包囲するアイソレーション領域 と、各アイソレーション領域を隔てて入力及び出力配線 パターンの少なくとも一部を包囲するようにプリント配 線基板上の所定の範囲に亙って形成されたアースパター ンと、が形成されたものにおいて、前記アースパターン には、該アースパターンを、入力側アースパターンと、 出力側アースパターンとに電気的に分断するための絶縁 40 ラインが形成されていることを特徴とする。請求項2の 発明は、パッケージの底面もしくは側面に形成した入力 端子及び出力端子と、該入力端子及び出力端子と夫々対 となるようにパッケージの底面もしくは側面に形成した 入力側アース端子及び出力側アース端子と、を備えた圧 電デバイスと、この圧電デバイスを搭載するプリント配 線基板と、から成るプリント配線基板ユニットであっ て、前記プリント配線基板には、入力端子に対応する入 力配線パターンと、出力端子に対応する出力配線パター ンと、入力側アース端子に対応する入力側アースパター 50

ンと、出力側アース端子に対応する出力側アースパターンと、が形成されており、前記2つのアースパターンが 互いに分離されていることを特徴とする。請求項3の発明は、入力端子及び出力端子と、該入力端子及び出力端子とでれぞれ対となる入力側アース端子及び出力側アース端子とを有する圧電デバイスと、この圧電デバイスを 搭載するプリント配線基板 とから成るプリント配線基板 ユニットであって、前記入力端子から供給されアースを 接近に流れる信号電流によって生ずるアース電位が前記出力端子から出力される出力信号に与える影響を軽減するように、前記プリント配線基板上のアースパターンと出力側アースパターンと出力側アースパターンと出力側アースパターンと出力側アースパターンと開したことを特徴とする。請求項4の発明の電子装置は、 請求項1、2、3又は4に記載のプリント配線基板ユニットを備えたことを特徴とする。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に示した形態 例により詳細に説明する。

[本発明の基本原理] なお、形態例の説明に先立って、 上記の不具合、即ち圧電デバイスをプリント基板上に実 装した場合に特性の劣化が発生する原因について考察す る。なお、図10~図13を併せて参照する。上述した ように高い周波数の圧電フィルタ1を入出力間のアース パターンが連結した状態にある共通アースパターン21 を有したプリント配線基板 20上に実装した場合に、阻 止域の減衰量が著しく低下する原因を推測すると、次の 理由ではなかろうかと考えられる。即ち、帯域通過型S AWフィルタを考えると、入力端子13aに供給された 信号のうち通過帯域周波数の信号はほとんど減衰せず出 力端子12aに伝達されるのに対し、阻止域周波数の信 号については入力側 I D T を介してアースに流れ、出力 端子12aに伝達されるエネルギーは小さくなる。一 方、周知の通り、幅広の共通アースパターンといえどい も僅かながらインダクタンス成分(コイルとしての機 能)を有しており、インダクタンスによるリアクタン ス、即ち電流阻止成分は周波数に比例する (X = j ω L、 $\omega = 2\pi$ f、Lインダクタンス)。即ち、入力端子 13aに供給された信号の一部が流れる電流路に共通ア ースパターン21によるインダクタンスが存在すれば、 その両端にはインダクタンス成分と流れる電流及び周波 数に比例した起電力が生ずる。もし、この起電力が出力 端子12aに影響するとすれば、阻止域の減衰量が低下 するであろうことは理解できる。この現象を等価回路で 表すと図8の如くなる。即ち、従来通り、入出力端子間 のアースパターンが連結されたものは、図8に示すよう に入力IDTと出力IDTとに共通にアース抵抗R。ま たは及びアースインダクタンスL。が挿入されたものと なる。従って、出力端子に現れる信号にはこれらアース 抵抗R。やアースインダクタンスL。による起電力が加 算され、その結果阻止域の減衰量が低下するのであろう

と推測される。そこで、実験によって入力端子側と出力 端子側の各アースパターンの連結を除去する手段を講じ たところ、圧電デバイス本来の特性を得ることができ た。この現象は図9の等価回路にて示すことができるの ではなかろうかと考えられる。即ち、入力端側と出力端 側のアースが分離される結果、入力IDTと出力IDT に共通するアースラインがなくなり、上記不具合が発生 しなくなる。尚、上記効果は圧電デバイス直下、若しく は、入力端側と出力端側近傍に位置する連続アース部分 (共通アースパターン21) においてより顕著であるこ 10 とが実験によって確認済みである。即ち、入力IDTや 出力IDTから所要距離離れた位置において入力端側ア ースと出力端側アースが電気的に接続されていても、従 来のような不具合を生じないことがある。よって本発明 の基本的な考え方は、入力端子から供給されアースパタ ーンに流れる信号電流によって生ずるアース電位が、出 力信号に与える影響がなくなるように、若しくは小さく なるように、入力端側アースパターンと出力端側アース パターンとを分離したことを特徴とするものである。

【0007】[第1の実施形態]次に、上記した本発明 20 の原理に基づいて開発したプリント配線基板ユニットの 構成例について説明する。図1は本発明の一形態例のプ リント配線基板ユニットの構成説明図であり、圧電デバ イスとしてのSAWフィルタ1については、上記従来例 のものと構成が変わりないので、図10に示した例と同 一部分には同一符号を付して説明する。また、プリント 配線基板20については、図10と同じ部分については 同一符号を付す。この形態例の特徴的な構成は、プリン ト配線基板20上のアースパターン21を細幅帯状の絶 縁ライン30によって分断することにより、出力側アー 30 スパターン31と、入力側アースパターン32とに分離 した点にある。絶縁ライン30は、図10に示した共通 アースパターン21のうち、両配線パターン24、25 の間に位置する部分を線状に除去することにより基板上 面を露出させた領域であり、絶縁ライン30によって各 アースパターン31、32間は電気的に隔絶されてい る。このような構成を備えたプリント配線基板20上に SAWデバイス1を搭載する場合には、点線で示すよう にデバイス側の出力端子12a, 入力端子13aが夫々 出力配線パターン24、入力配線パターン25と接続さ 40 れるように載置する。この際、出力側アース端子12 b, 12cは出力側アースパターン31と接続され、入 力側アース端子13b,13cは入力側アースパターン 32と接続される。このような構成のプリント配線基板 ユニットについてSAWデバイスの特性を測定したとこ ろ、フィルタ特性は図2に示すように、図12の場合に 比べて約10dB程度、低周波側の減衰特性が改善され た。

【0008】 [第2の実施形態] 次に、図3は本発明の 第2の実施形態のプリント配線基板ユニットの構成を示 50

す平面図であり、このユニットを試作したものを用いて 特性についての実験を行った。実験に用いた圧電デバイ スは、1-3次縦結合2重モードSAWフィルタであ り、これを2個縦続接続したフィルタであるため、入出 力側それぞれに2つのアース端子を有する。そこで2つ のアース端子間の分離を行うべく図示のような絶縁ライ ン40、41を追加した。この絶縁ライン40、41 は、各アイソレーション領域22、23から絶縁ライン 30に向けて導出されたスリット状の絶縁領域であり、 絶縁ライン40、41を設けることにより圧電デバイス 載置位置に載置されたSAWフィルタ1の出力側のアー ス端子12b, 12c間のアース電流の通電経路と、入 力側のアース端子13b, 13c間の通電経路が、夫々 絶縁ライン40、41を経ない外側の迂回経路となるよ うに構成している。このように、アース電流の通電経路 を長く構成してその影響を確認したところ、図 4 に示し た如きフィルタ特性を確認することができた。即ち、こ の形態例によるフィルタ特性は、第1の実施形態よりも 効果的には劣るものの、従来のフィルタ特性と比べれば 大幅に改善されていることが判る。

[第3の実施形態] 図5は本発明の第3の実施形態のプリント配線基板ユニットにおけるアースパターンを示す平面図であり、これも2つのアース端子間を分離するための構成である。この形態例では、デバイス側のアース端子12b,12c,13b,13cに夫々コ字状の絶縁ライン45、46を形成することにより、出力側のアース端子12b,12c間のアース電流の通電経路が、夫々絶縁ライン45、46を経ない外側の迂回経路となるように構成している。このプリント配線基板上に搭載されたSAWデバイスの特性を測定したところ、この形態例によるフィルタ特性は、第1の実施形態のものよりも効果的には劣るものの、従来のフィルタ特性と比べれば大幅に改善されていることが判った。

【0009】[第4の実施形態] 次に、図6は本発明の第4の実施形態に使用するプリント配線基板の平面図であり、この形態例では、図5に示した形態例中から絶縁ライン30を除去して共通アースパターン21を再現させると共に、図5中のコ字状の絶縁ライン45、46の遊端部を夫々横方向に長尺に伸ばすことにより、上記アース電流の通電経路を更に長くしている。即ち、出力端子12bと入力端子13b間のアース電流の通電経路と、出力端子12cと入力端子13c間のアース電流の通電経路を夫々長くするように配慮したものである。この形態例では、入力と出力のアースパターンを、完全に分離するのではなくアース電流の経路を遠くすることにより、高周波的にはアースパターンを分離した場合とより、高周波的にはアースパターンを分離した場合とにはなり、高周波的にはアースパターンを分離した場合とはなり、高周波的にはアースパターンを分離した場合とは成の作用が得られるのではないかと考えて、同図のような構成についても実験した。これについても第1の実施

(5)

形態の場合よりも若干劣るものの、同様の特性改善効果 を確認することができた。

【0010】 [その他の変形例] 上記各形態例では、出 力配線パターン24、及び入力配線パターン25を、ア ースパターンが完全に包囲する例を示したが、これは一 例に過ぎず、例えば図7に示した配線のように出力配線 パターン24及び入力配線パターン25の一部だけを、 夫々出力側アースパターン50、51により囲む(挟 む) ように構成してもよい。そして、点線で示した圧電 デバイス搭載位置に圧電デバイスを搭載した時に、出力 10 端子12a及び入力端子13aが、夫々出力配線パター ン24及び入力配線パターン25に対応して接続され、 出力端子12a及び入力端子13aの両側に夫々位置す るアース端子12b, 12c, 及び13b, 13cは、 出力配線パターン24、及び入力配線パターン25の両 側に絶縁ライン55、56を介して配置されたアースパ ターン50、51と接続される。上記した各形態例で は、1-3次2重モードSAWフィルタを2段階縦続接 続した圧電デバイスを例として説明したが、本発明のプ リント配線基板の配線構造は、その他のSAWフィルタ 20 や圧電フィルタを搭載する場合にも適用可能である。ま た、近年では小型化の要求から、プリント配線基板上に 直接SAWフィルタ等のチップを搭載するチップ・オン ボード (COB) タイプの要請が高くなっているが、 本発明はCOBに対しても適用可能であり、このときチ ップ部品と配線パターンとの接続は、ワイヤボンディン グや、いわゆるフリップチップ方式が考えられるが、い ずれの方式であっても適用可能であることはいうまでも ない。なお、各請求項において、圧電デバイスとは、パ ッケージ内に圧電素子を収容したタイプのみならず、S AWフィルタ等のチップをも含む概念である。また、上 記各形態例に示したプリント配線基板ユニットは、これ を通信機器、その他の電子機器に搭載することにより、 各機器の性能の向上に資することは明らかである。

[0011]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、プリント配線基板上に、圧電フィルタ等の圧電デバイスを搭載した場合においても、搭載前のデバイス単独の状態における特性と同等のフィルタ特性が得られるプリント配線基板ユニットを提供することができる。即ち、請求項1の 40 発明は、プリント配線基板上に、入力端子及び出力端子に夫々対応する入力配線パターン及び出力配線パターンと、この入力及び出力配線パターンの失々の少なくとも一部を包囲するアイソレーション領域を隔てて入力及び出力配線パターンの少なくとも一部を包囲するようにプリント配線基板上の所定の範囲に亙って形成されたアースパターンと、を形成すると共に、アースパターンには、該アースパターンを、入力側アースパターンと、出力側アースパターンとに電気的に分断するための絶縁ラインが形成されている。これ 50

を換言すれば、入力端子から供給されアースパタ ーンに 流れる信号電流によって生ずるアース電位が、出力信号 に与える影響がなくなるように、若しくは小さく なるよ うに、入力端側アースパターンと出力端側アースパター ンとを分離した。このように、入力端子側と出力端子側 の各アースパターンの連結を解除したので、阻止域の減 衰量の低下が防止されて圧電デバイス本来の特性を得る ことができた。即ち、入力端側と出力端側のアースが分 離される結果、入力IDTと出力IDTに共通するアー スラインがなくなり、上記不具合が発生しなくなる。請 求項2の発明では、プリント配線基板に、入力端子に対 応する入力配線パターンと、出力端子に対応する出力配 線パターンと、入力側アース端子に対応する入力側アー スパターンと、出力側アース端子に対応する出力側アー スパターンと、が形成されている。この発明では、入出 力配線パターンや、入出力側アースパターンの形状、配 置等を限定することなく、入力端子側と出力端子側の各 アースパターンの連結を解除したり、連結を解除しない 共通アースパターン上におけるアース端子間のアース電 流の通過回路を迂回経路としたので、阻止域の減衰量の 低下が防止されて圧電デバイス本来の特性を得ることが できた。請求項3の発明では、入力端子及び出力端子 と、該入力端子及び出力端子とぞれぞれ対となる入力側 アース端子及び出力側アース端子とを有する圧電デバイ スと、この圧電デバイスを搭載するプリント配線基板と から成るプリント配線基板ユニットであって、前記入力 端子から供給されアース端子に流れる信号電流によって 生ずるアース電位が前記出力端子から出力される出力信 号に与える影響を軽減するように、前記プリント配線基 板上のアースパターンを、入力側アースパターンと出力 側アースパターンとに分離したので、圧電素子を収納し た圧電デバイスのみならず、圧電素子を直接プリント配 線基板上の配線パターン上に搭載するタイプのプリント 配線基板ユニットに対しても適用することができ、上記 他の請求項の場合と同等の効果を発揮させることができ る。請求項4では、上記各請求項記載のプリント配線基 板ユニットを各種電子装置に搭載することにより、各請 求項に対応する効果を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態のプリント配線基板ユニットの構成説明図。

【図2】図1の実施形態のフィルタ特性を示す図。

【図3】本発明の第2の実施形態のプリント配線基板ユニットの構成説明図。

【図4】図3の実施形態のフィルタ特性を示す図。

【図 5 】本発明の第 3 の実施形態のプリント配線基板ユニットの構成説明図。

【図6】本発明の第4の実施形態のプリント配線基板ユニットの構成説明図。

【図7】本発明の他の形態例のプリント配線基板ユニッ

トの要部構成説明図。

【図8】従来の共通アースパターンを備えたプリント配 線基板ユニットの等価回路図。

【図9】本発明によるアースパターンを備えたプリント 配線基板ユニットの等価回路図。

【図10】(a)(b)及び(c)は従来の圧電デバイスの一 例としてのSAWデバイスの構造を示す正面縦断面図、 平面横断面図、及び底面図。

【図11】(a) 及び(b) はこのSAWデバイスをプリン ト配線基板上に実装する手順、及び実装後の状態を示す 10 プリント配線基板、21 共通アースパターン、22, 斜視図。

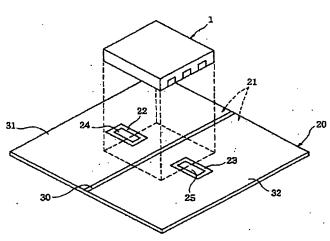
【図12】プリント配線基板上に実装されたSAWデバ イスのフィルタ特性を示す図。

【図13】実装されないSAWデバイス単体のフィルタ 特性を示す図。

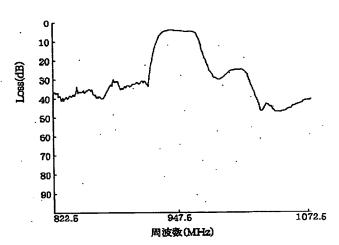
【符号の説明】

1 圧電デバイス (SAWデバイス)、2 セラミック パッケージ、3 SAWデバイスチップ、4、5 段 部、6 6 (6a, 6b, 6c)、7 (7a, 7b, 7 c) 導通パッド、8 (8a, 8b, 8c)、9 (9 a, 9b, 9c) 電極、10 ワイヤ、11 導電パ ターン、12 出力側端子群、12a 出力端子, 12 b, 12c アース端子、13 入力側端子群13、1 3 a 入力端子, 13b, 13c アース端子, 20 23 アイソレーション領域, 24 出力配線パター ン, 25入力配線パターン, 30, 31 同軸ケーブ ル,30 絶縁ライン,31 出力側アースパターン, 32 入力側アースパターン, 40, 41 絶縁ライ ン、45、46 絶縁ライン。

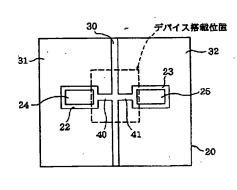




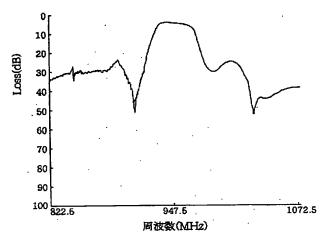
【図2】

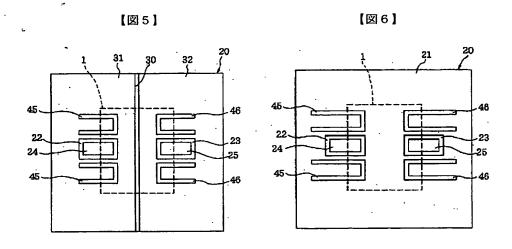


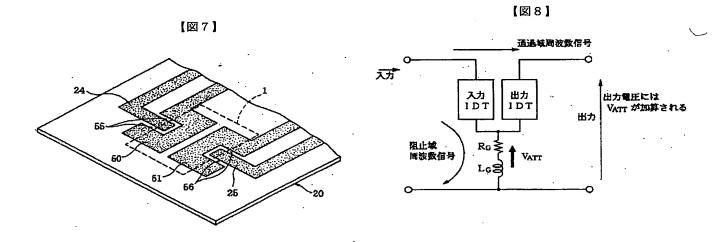
【図3】

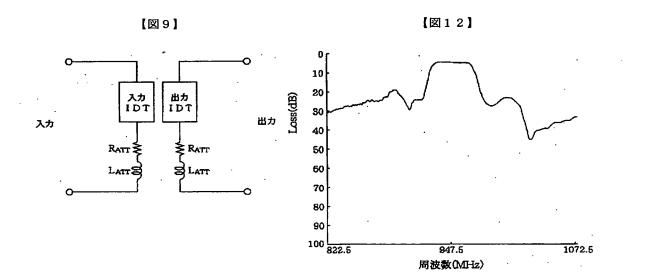


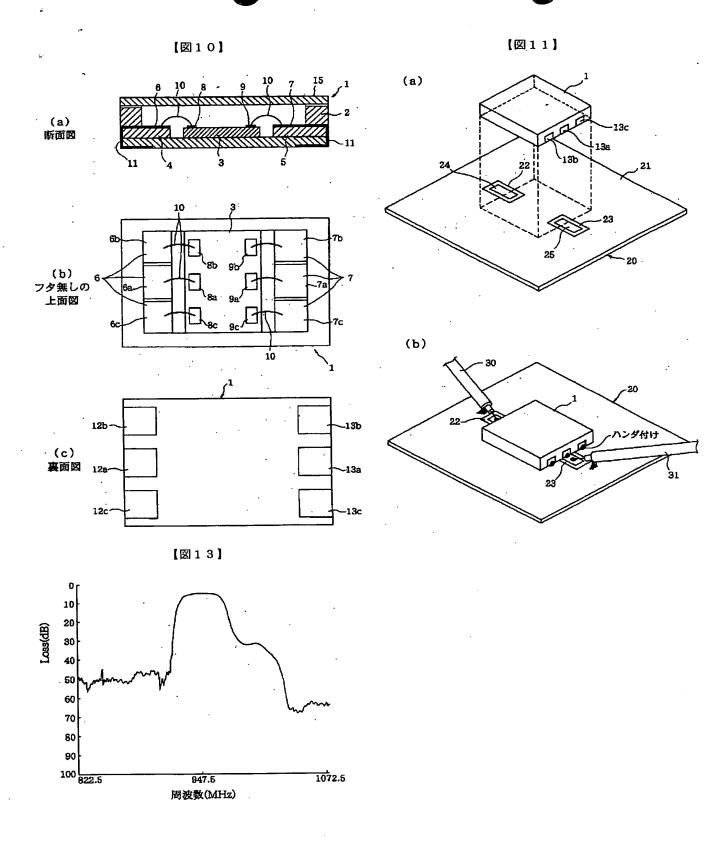
【図4】











į